

半导体晶圆片切割 单晶硅 多晶硅 精细钻孔切圆切方异形皆可

产品名称	半导体晶圆片切割 单晶硅 多晶硅 精细钻孔切圆切方异形皆可
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	华诺激光:微纳切割打孔定制 加工设备:皮秒, 纳秒 加工地:北京
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

半导体晶圆片切割 单晶硅 多晶硅 精细钻孔切圆切方异形皆可。华诺激光切割打孔，承接0.13mm-20mm各种激光切割、开孔钻孔、划线、开槽、刻图形字体，各种透光材质都可做，价格优惠。

产品用途：广泛应用于科研、光电、电子、医疗、电光源、半导体、光学新技术等方面。

公司内部的业务范围分为：1.微细加工部（精密切割、微小孔加工）、2.激光打标部(包括雕刻、切割)、3.礼品定制部、4.激光焊接部。